

键合机

所属学校:重庆大学

仪器基本信息			仪 器 编 号		08023815			
			仪器英文名称		Substrate Bonder			
			所属校内单位		光电工程学院			
			放 置 地 点		A 区微系统研究中心 MEMS 工艺间			
			仪器负责人		李东玲	制造商国别	德国	
			制 造 厂 商		休斯微技术股份有限公司			
			规 格 型 号		SB6e			
			仪 器 原 值		133.31 万元	购置日期	2008.12	
仪器性能信息	主要技术指标	极限真空 5×10^{-5} mbar, 对准漂移 $\leq 3\mu\text{m}$ 。						
	主要功能及特色	将不同的衬底键合在一起,可进行硅/玻璃阳极键合、共熔、热压及 SOI 等。						
相关科研信息	主要研究方向	电子、通信与自动控制技术;科学研究。						
	在研或曾承担的重大项目	北大金硅键合、无锡纳微阳极键合、二维加速度计、电子科大阳极键合、真空、一种新型声波生化传感器及其集成技术研究、基于 MEMS 的微型风力发电机系统研究。						
	学术 论文	近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:						
		序号	作者	论文题目	期刊名称	年	卷(期)	起止页
		1	Xuefeng He	Application of Active Control Technology for Mass Resolution Improvement of FBAR	5th IEEE International Conference on NEMS	2010	5(11)	1097 - 1101
		2	徐溢	流控电泳芯片集成电导检测研究进展	压电与声光	2010	32(4)	671 - 676
专利或奖项								
共享服务信息	收费标准	联盟外	根据具体实验项目协商					
		联盟内	根据具体实验项目协商					
	联系信息	联系人	李东玲	联系电话	65102519	电子邮件	cqnpwsq@cqu.edu.cn	
	开放时间	提前预约						